

2025 年 1 月吉日

御 得 意 様 各 位

第 26 回 半導体・センサパッケージング展 出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社は、東京ビッグサイトで開催される「ネプコンジャパン 第 26 回 半導体・センサパッケージング展」に出展する運びとなりました。本展示会では、弊社の専門スタッフが常駐し、製品・技術に関するご質問や、ご相談に直接お答えいたします。さらに、今回は半導体業界で非常に重要な材料として広く利用されている「低αすず」をご紹介いたします。皆様にとって価値ある情報をご提供できることと存じます

ご多忙中とは存じますが、何卒ご来場承りますようお願い申し上げます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

日 時：2025 年 1 月 22 日(水)~1 月 24 日(金)

開場時間：10：00~17：00

会 場：東京ビッグサイト：東展示場 第 7 ホール E65-57

来場登録 URL：<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1218395866460678-KUB>

